

LD-966、RULER无铅锡膏

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LD-966、RULER无铅锡膏 |
| 公司名称 | 上海镭垒电子材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:LD-966 品牌:RULER 外观:光亮 |
| 公司地址 | 上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号240室 |
| 联系电话 | 13918705156 13353910105 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------------------|-----|-------|
| 型号 | LD-966 | 品牌 | RULER |
| 外观 | 光亮 | PH值 | 国标 |
| 有效物质含量 | SN96.5AG3CU0.5 (%) | 浊点 | 国标 |
| CAS | 国标 | | |

锡膏

1. 表面贴装用焊锡膏

锡膏的特性在电路板表面贴装工程里扮演很重要的角色，因此为了要达到理想又稳定的焊锡效果，选择合适的锡膏是决定性的因素。选择锡膏所要考虑的因素包括合金含量、锡粉筛目和助焊剂的类型。

2. 锡膏合金的选择

我公司所有的锡膏都是采用高纯度的合金粉及良好的制程控制而生产。其锡粉是根据ansi/j-std006标准而制成。在电路板组装及表面贴装工程里最普遍使用的锡铅合金是锡63铅37和锡62铅36银2;最常用的无铅锡膏为sn96.5ag3cu0.5或sn99.7cu0.3。

3. 锡粉的颗粒分布

我公司所用的锡粉是在氮气环境中及严格的品管制程控制之下来生产，在这种制程下所生产的锡粉纯度高、低氧含量及颗粒散布一致。为了保存锡粉新鲜以及不会氧化，每一包锡粉都是采用真空包装。

4. 膏合金的锡选择

| | |
|------|------|
| 合金 | 熔点 |
| 固态温度 | 液态温度 |

| | | |
|----------------|-----|-----|
| sn63pb37 | 183 | 183 |
| sn62pb36ag2 | 179 | 179 |
| sn96pb2ag2 | 268 | 302 |
| sn60pb35bi3ag2 | 178 | 178 |
| sn43pb43bi14 | 114 | 163 |
| sn42bi58 | 138 | 138 |
| sn64bi35ag1 | 172 | 172 |
| sn99.7cu0.3 | 227 | 227 |
| sn96.5ag3cu0.5 | 217 | 217 |

5. 锡膏合金的包装

| 罐装 | 管状包装 | 针筒包装 | |
|------|------|------|-------|
| 250克 | 500克 | 35克 | 10c.c |
| 500克 | | 100克 | 30c.c |

6. 焊锡膏标准类别及代表特性（免洗型）

| 型号 | ld960-h | ld961-h | ld961-f | ld860-h | ld861-h | ld966 | ld967 | ld968 | |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 合金成分 | sn63pb37 | sn63pb37 | sn62pb36 ag2 | sn63pb37 | sn63pb37 | sn96.5ag3 cu0.5 | sn60pb35 bi3ag2 | sn96.5ag3 cu0.5 | |
| 熔点 | 183 | 183 | 179 | 183 | 183 | 217 | 178 | 183 | |
| 助焊剂含量(%) | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 11 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | 10 ± 0.5 | |
| 粒径(μm) | 25~45 | 25~45 | 25~45 | 10~40 | 20~45 | 25~45 | 25~45 | 25~45 | |
| 含卤量 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 粘度(25℃) | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | 180~220 | |
| 铜板腐蚀性 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | 无腐蚀 | |
| 铜镜实验 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 绝缘电阻 | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | > 1 × 10 ¹² | |
| 焊锡扩散率(%) | 92 | 92 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | |
| 锡粉形状 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | |
| 印刷最小间距mm | > 0.3 | > 0.3 | > 0.3 | > 0.25 | > 0.3 | > 0.3 | > 0.3 | > 0.3 | |
| 特长 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 不含卤 印刷性能好 焊点光亮 | 无铅贴片锡膏 不含卤 焊点光亮 | 插件锡膏焊点 柔和不含卤 | 无铅 焊点光亮 |

7. 标准的温度曲线图

建议参考图1，若设备不适合时也可参考图2。